

プローブカード用有機プリント基板

最先端の革新技術により、高周波領域まで高い信号品質を維持しつつ、大容量の配線収容を実現するプローブカード用有機プリント基板をご提供

高密度・高多層・高速伝送基板技術で、半導体プローブ装置のニーズに対応

飛躍的な配線収容と自由な部品配置を実現

F-ALCS 技術の適用で、従来比で2倍以上、35,000本以上の配線が収容可能に

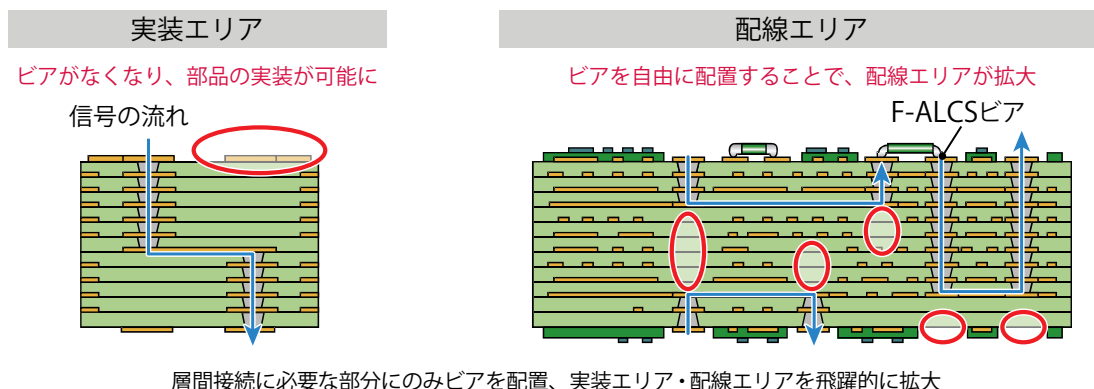
一括積層技術で、製造納期短縮を実現

一括積層工法により、製造工数を従来比較で約50%削減し、製造納期の短縮に貢献

全層スタブレス構造による高速・高周波対応を実現

F-ALCS技術の適用により、狭ピッチコンタクトと高周波試験(>5GHz)を可能に

F-ALCS構造のメリット

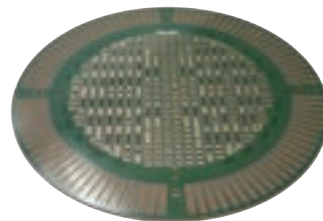


製品事例



ロジックIC測定用有機プローブカード基板
(インターポーザ・タイプ)

層構成	42層 (7+28(F-ALCS)+7)
基板サイズ、厚さ	100mm×100mm、2.7mm
ネット数、パッドピッチ、抵抗 (信号)	500nets/DUT、125μm、R<2Ω



メモリー用有機プローブカード基板

層構成	74層 (F-ALCS)
基板サイズ、厚さ	φ 520mm、7.4mm
ネット数 (信号)	30,000wires

